

6-104809-1 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU MTE

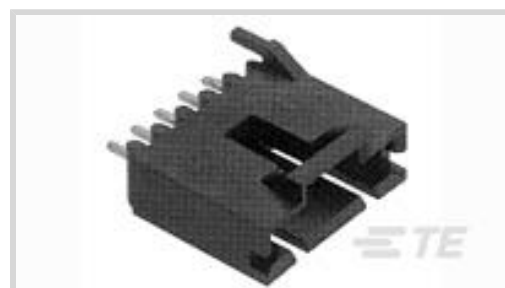
TE 内部编号 6-104809-1

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 12 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU MTE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 线到板

位数: 12

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 连接器系统 | 线到板 |
| 接头类型 | 全部带罩 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

结构特性

| | |
|----------|----|
| 位数 | 12 |
| 行数 | 1 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

| | |
|------------|---------|
| 端接电阻 | 15 mΩ |
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
| 介质耐压 (最大值) | 600 V |

主体特性

| | |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

| | |
|---------|------------------|
| 端子接触部长度 | 5.84 mm [.23 in] |
| 接合方柱尺寸 | .64 mm [.025 in] |



| | |
|--------------------|------------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2.54 μm[100 μin] |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .381 μm[15 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 端子形状和构造 | 正方形 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 黄铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流（最大值） | 3 A |

端接特性

| | |
|-------------|-----------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| 端接柱体和尾部长度 | 3.3 mm[.13 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

机械附件

| | |
|------------|------------|
| PCB 安装对准类型 | 定位柱 |
| 接合对准类型 | 极化, 极化, 锁存 |
| 接合固定 | 带有 |
| PCB 安装固定类型 | 陷型固定尾 |
| 接合固定类型 | 压紧 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 带有 |
| PCB 安装固定 | 带有 |

壳体特性

| | |
|---------|----------------|
| 外壳材料 | 热塑性 |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

| | |
|------------|-------------------|
| 连接器长度 | 33.02 mm[1.3 in] |
| 连接器高度 | 13.59 mm[.535 in] |
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in] |

使用环境

| | |
|---------|---|
| 壳体温度额定值 | 高 |
|---------|---|



工作温度范围 -65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用 Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容 CSA LR7189, UL E28476

UL 阻燃性等级 UL 94V-0

包装特性

封装数量 16

封装方法 Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)
不含REACH SVHC

卤素含量 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力 回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE



客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-104809-1_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-104809-1_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-104809-1_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT](#)

英文版本

[AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本